

无硅导热膏

【产品概述】

AG560-50 无硅导热膏是一种导热界面材料的非硅膏状化合物, 不易变干; 它可以把热能从发热设备引导至散热片和底盘上. 该产品在导热金属氧化物被填充的情况下依然能够绝缘导热. AG560-50 有低渗透性, 良好的耐高温性和低流动性的特点, 无硅烷小分子挥发, 不会产生碳化硅引起电路不良.

【产品图示】



特性参数 AG560-50		
产品性能	测试结果	测试标准
颜色	灰色	目视
粘度 25°C	300K cps	Brookfield RVF, #7
密度 g/cm ³	2.8	***
使用温度 °F/ °C	-45 to 130°C	***
导热率 W/mK	5.0	ASTM D5470
热阻 (°C-in ² /W)@50psi	0.07	ASTM D5470
RoHS	PASS	IEC 62321
Halogen	PASS	EN14582
REACH	PASS	EN14372

使用 ASTM D5470 测试夹具。记录值包括界面热阻。这些数值仅供参考。实际应用性能直接关系到所施加的表面粗糙度、平整度和压力。

【特点与优势】

- 导热率 5.0W/mK
- 耐干枯
- 符合 RoHS 要求
- 无硅氧烷挥发
- 无需预热
- 适用于自动配料及丝网印刷等生产工艺

【典型应用】

- 高频微处理器、手机
- 笔记本和台式电脑
- 计算机
- 电源适配器
- 音频视频设备
- LED 照明产品

【储存&运输】 贮存于通风、阴凉、干燥处, 不要接触明火。本产品无毒, 按非危险品贮存及运输。

【包装】 根据客户需求定制包装

【有效期】 本产品有效期为 24 个月

【安全】 请参阅本公司《材料安全性能数据 (MSDS) 》

以上这些建议及数据均来自我们认为可靠的资料。虽然是以诚信提供, 但由于我们无法控制产品的使用条件和方法, 无法对兼容性的应用提出任何建议, 因此这些建议及数据仅供参考, 而不作为产品保证。在任何时候, 应由用户最终决定他们的生产线是否能够有效地使用。应由买方决定产品是否合适或适用特殊用途。不保证产品质量或适用性可满足任何特殊用途。我们建议潜在用户在大量使用前, 首先确定我们的材料适用性和建议。